

招商证券股份有限公司  
关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

## 声 明

本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》（下称“《审核规则》”）等法律法规、行政法规和中国证监会及上海证券交易所（下称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

在本上市保荐书中，除非另有说明，所用简称与招股说明书保持一致。

## 目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
一、公司基本情况.....	3
二、本次发行情况.....	11
三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍.....	12
四、保荐机构与发行人之间的关联关系.....	13
五、保荐机构的承诺.....	14
六、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序.....	15
七、保荐机构对发行人符合科创板定位的核查情况.....	16
八、保荐机构关于发行人符合科创板上市条件的说明.....	20
九、对公司持续督导期间的工作安排.....	24
十、保荐机构认为应当说明的其他事项.....	26
十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论.....	26

## 一、公司基本情况

### （一）公司基本信息

发行人名称	江苏鑫华半导体科技股份有限公司
注册地点	徐州经济技术开发区杨山路 66 号
注册时间	2015 年 12 月 11 日
联系方式	0516-83958888
业务范围	半导体材料、电子材料、高纯材料及副产品的研发、制造、销售及技术服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品或技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
本次证券发行类型	首次公开发行 A 股股票并在科创板上市

### （二）发行人的主营业务

公司主要从事半导体产业用电子级多晶硅的研发、生产与销售。半导体制造产业链始于电子级多晶硅，至半导体硅片和晶圆制造，最终产出集成电路芯片用于终端产品。作为我国实现高水平科技自立自强的重要产业领域，半导体制造产业具有重大战略意义。公司生产的电子级多晶硅是支撑整个半导体制造产业的关键基础材料，直接应用于半导体硅片与半导体用硅部件生产。

半导体硅材料产业市场规模占半导体制造材料市场规模的 30%左右，是半导体制造中占比最高的主材料。普通工业硅纯度为 98%左右，而半导体制造对电子级多晶硅技术指标要求十分严苛，当硼、磷或其他金属元素作为杂质存在于多晶硅中时，制成的硅片产品质量难以控制，因此需要极高的多晶硅纯度，对纯度要求需达到 11N（即 99.99999999%）以上，施主杂质含量和受主杂质含量均需达到 ppta（万亿分之一原子比）级别，且需在万吨级大规模生产中维持技术指标的高度一致性。自上世纪 80 年代以来，高纯电子级多晶硅作为行业基础原材料，技术被德国、美国、日本少数企业所垄断，全球具备成熟技术、能够大规模稳定供应的厂商在 5 家以内，国内市场化供应能力几乎为零，严重制约中国半导体产业的发展。为了解决国产化替代难题，公司自成立以来，便以“填补国内半导体级多晶硅国产化空白”战略目标为指导，坚持以科技创新为核心，致力于关键技术的研究和开发，先后建成徐州 5,000 吨/年（后扩产至 8,000 吨/年）和内蒙 10,000

吨/年电子级多晶硅生产线，成功实现半导体产业用电子级多晶硅的大规模稳定生产，打破了国外在技术与市场上的双重垄断，填补了国内相关领域的空白。公司电子级多晶硅各项关键指标已全面达到国际先进水平，顺利通过国内外主流客户验证，产品应用领域实现了从 12 英寸硅片、6-8 英寸硅片至小尺寸硅片及硅部件的全覆盖，保障国产硅片及硅部件产业的正常运行和发展。

目前，公司正在继续加大投入以攻克超高纯电子级多晶硅技术。超高纯电子级多晶硅是电子级多晶硅中的全球前沿产品，包括超高阻电子级多晶硅和区熔用多晶硅，纯度可达到 13N 以上。其中，超高阻电子级多晶硅较普通电子级多晶硅电阻率更高、杂质含量更低，是先进制程集成电路的核心基材，其超高纯度与极低杂质特性直接决定芯片性能与功耗水平，是 AI 芯片、硅光子芯片等尖端集成电路性能跃升的重要基础，为我国集成电路制造领域向先进制程和高端化发展提供关键支撑。区熔用多晶硅是电子级多晶硅中占比相对较小但不可或缺、技术难度更高的部分，在 IGBT 功率器件、高端射频器件、微电子机械系统以及各类高精度探测器、传感器等战略领域具有关键应用价值。公司目前在超高阻电子级多晶硅和区熔用多晶硅的产品技术研发及生产方面均已取得突破性进展，相关产品通过部分国内外主流客户验证，并实现小批量出货。

此外，基于多年电子级多晶硅研发生产所积累的高纯硅基产品技术，公司正在积极进行硅基电子特气和高纯石英砂等围绕高纯硅基材料的多元化产品研究开发工作。

公司依托在电子级多晶硅领域的技术积累，积极承担国家及地方重大科技攻关任务。公司是国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》（02 专项）中《电子级多晶硅材料研发》的具体实施单位；公司承接的工信部“国家工业强基工程”项目，已顺利通过验收；同时，公司还承担了“江苏省工业和信息产业转型升级项目”“江苏省关键核心技术攻关项目”以及“江苏省重点研发计划项目”等多项省级重点科技专项。此外，公司积极参与国家及行业标准体系建设，作为牵头单位完成了最新版《电子级多晶硅》（GB/T 12963-2022）国家标准的修订，并参与多项国家标准、行业标准的制定和修订工作。公司是国家级专精特新“小巨人”企业。

### （三）核心技术及研发水平

#### 1、核心技术情况

发行人是国内领先的电子级多晶硅材料供应商。发行人自成立以来长期专注于电子级多晶硅材料的研发、生产和销售，持续积累并优化核心技术。

发行人的核心技术是发行人的主要竞争力之一。经过多年的技术实践与积累，发行人突破并优化了多项关键技术，自主研发了电子级多晶硅长周期稳定量产产业化技术、ppt 级氯硅烷痕量杂质纯化技术、高效 CVD 可控晶体沉积技术、硅棒洁净破碎、硅块洁净刻蚀等 11 项主要核心技术，构建了较高的技术壁垒，发行人拥有的改良西门子法电子级多晶硅生产工艺技术已处于国际先进水平。

发行人掌握的核心技术情况如下：

序号	核心技术名称	技术来源	核心技术应用的具体生产环节	相关专利情况	技术所处阶段
1	电子级多晶硅长周期稳定量产产业化技术	自主研发	电子级多晶硅生产系统	已授权发明专利 11 项	大批量生产
2	ppt 级氯硅烷痕量杂质纯化技术		精馏工序	已授权发明专利 4 项	大批量生产
3	高效 CVD 可控晶体沉积技术		还原工序	已授权发明专利 4 项	大批量生产
4	还原炉及配套辅助设备开发技术			已授权发明专利 9 项	大批量生产
5	还原尾气分离及氢气提纯技术		尾气回收工序	已授权发明专利 2 项	大批量生产
6	硅棒洁净破碎技术		后处理工序	已授权发明专利 4 项	大批量生产
7	硅块筛分技术			已授权发明专利 1 项	大批量生产
8	硅块洁净刻蚀技术			已授权发明专利 7 项	大批量生产
9	痕量杂质检测技术		检测工序	已授权发明专利 3 项	大批量生产
10	区熔用多晶硅棒生产技术		-	已授权发明专利 3 项	试生产
11	硅基特气生产技术		气体提纯及充装工序	已授权发明专利 1 项	试生产

#### 2、研发情况

##### （1）在研项目情况

截至报告期末，发行人尚未结项的研发项目及进展情况具体如下：

序号	在研项目名称	进展情况	拟达到的目标
1	超高纯电子级多晶硅工艺及设备的开发	正在研发	针对超高阻硅片及先进制程用硅片的需求，通过对全流程ppt级痕量杂质的在线管控，优化提升三氯氢硅中难除杂质定向吸附提纯技术，优化硅料表面精制过程对表面金属及有机物等杂质去除和防护能力，优化晶体沉积过程中对晶体形态及杂质选择性沉积过程，大幅度提升现有电子级多晶硅长周期杂质控制稳定性及内在晶体生长形态
2	电子级多晶硅衍生产品的开发与应用		开发电子级三氯氢硅充装核心工艺及电子级二氯氢硅提纯及充装核心工艺；开发碳化硅外延片关键技术开发，满足下游客户验证的需求；开发纳米硅表面修饰处理技术包括开发材料改性、电学性能提升技术，并建立电学性能测试线；突破高纯合成石英砂技术关键难题，使产品纯度达到7N以上级别；通过固化、碳化、活化等方式，打通树脂合成硅碳用多孔碳工艺流程，实现硅碳用多孔炭的可控低成本自主合成；开发各方面电化学性能均优于现在市场销售的硅碳材料
3	区熔用电子级多晶硅工艺及设备的开发		通过对还原炉及其附属电气设备开发、改造，满足超大尺寸区熔硅棒的生产要求；通过对沉积工艺和应力控制程序的开发，形成并固化具备良好成晶性能和机械性能的大尺寸区熔硅棒生产方法；通过开发区熔棒的机加工、酸洗、转运和包装设备，具备生产区熔硅棒成品的能力
4	还原关键工艺及设备的研发开发		针对新型还原炉进行制造研发，并对其应用于电子级多晶硅生产的工艺技术进行探索研究；开发升级还原炉复层材料、炉筒基材材料、底盘材质及冷却介质等；对还原炉电极头提纯方式、锻造形式、无损检测技术进行优化提升；对一炉多产联合生产工艺进行开发，降低还原炉单耗、提高生产效率；开发微波预热系统，实现微波预热系统对红外预热系统的完全替代
5	高效纯度提升及副产循环优化工艺的研究与开发		提高渣浆装置处理能力，降低去除渣料中杂质的时间，并解决脱高沸系统中杂质高及设备管线堵塞问题；对现有的氯化粗品输送工艺流程进行优化，提高输送的稳定性
6	电子级多晶硅相关检测技术的研究与应用		通过导入新分析模块，丰富异物检测手段，提升检测效率；通过氢气中杂质气体的测试方法开发，监控高纯氢气中的烃类、硼烷和磷烷杂质，控制气中的碳（烃类）和硼元素、磷元素杂质含量，减少多晶硅在还原炉生产过程中的杂质的引入，进而确保电子级多晶硅的质量稳定
7	后处理关键工艺及设备的研发开发		对硅芯控制籽晶夹头及母料底座的材质及结构进行研发，以减少硅芯控制过程中杂质的引入，同时通过对硅芯清洗配方、工艺流程和相关结构的优化，提升硅芯清洗质量

## (2) 研发投入情况

发行人历来重视技术创新以及新产品的研发，积极开展研发活动。报告期内，发行人研发费用口径的研发投入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
研发投入	6,743.02	7,173.67	5,287.76	5,723.41
营业收入	133,581.30	110,964.15	94,626.92	127,442.29
研发投入占比	5.05%	6.46%	5.59%	4.49%

#### (四) 发行人的主要经营和财务数据及指标

项目	2025年9月30日 /2025年1-9月	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
资产总额（万元）	581,793.78	577,871.33	561,314.64	275,742.68
归属于母公司所有者权益（万元）	283,856.49	269,070.68	260,271.93	153,846.07
资产负债率（母公司）	25.25%	26.80%	27.56%	40.90%
营业收入（万元）	133,581.30	110,964.15	94,626.92	127,442.29
主营业务收入（万元）	129,379.08	106,701.69	86,498.92	102,018.61
主营业务毛利（万元）	32,441.93	24,650.23	14,563.92	20,964.31
净利润（万元）	7,759.04	6,228.10	3,633.08	14,320.55
归属于母公司所有者的净利润（万元）	12,255.39	6,862.32	4,554.03	14,886.59
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,830.23	6,400.78	3,239.80	14,074.26
基本每股收益（元）	0.08	0.05	0.03	0.11
稀释每股收益（元）	0.08	0.05	0.03	0.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.30	2.43	1.91	8.70
经营活动产生的现金流量净额（万元）	6,571.34	15,304.28	5,748.98	27,652.10
现金分红（万元）	-	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	5.05%	6.47%	5.59%	4.49%

#### (五) 发行人存在的主要风险

本着勤勉尽责、诚实守信的原则，经过全面的尽职调查和审慎的核查，根据发行人的有关经营情况及业务特点，本保荐机构特对发行人以下风险做出提示和说明：

##### 1、公司在国内乃至国际市场与国际厂商竞争面临的不确定性风险

公司目前主要竞争对手为德国瓦克、美国 Hemlock、日本德山等国际厂商，

该等国际厂商已经历数十年乃至上百年的积累和发展，在技术积淀、产品品类、客户议价能力、经营规模、资本实力等方面具有优势，在全球市场已形成寡头垄断竞争格局。公司目前是國內主要的半导体产业用电子级多晶硅生产企业，也是 12 英寸硅片领域电子级多晶硅大规模稳定供应的唯一国产供应商，国内市场占有率超过 50%，国内市场其余份额和国际市场目前仍基本由境外厂商占据。截至目前，公司已成功进入国际一线硅片厂商供应链，包括环球晶圆、SK Siltron 等国际前五大硅片厂商中的两家，但销售规模仍较小。

在國內，公司要继续提升市场占有率，面临国际厂商更强阻力；在国外，电子级多晶硅国际厂商已与全球五大硅片厂商长期深度合作（包括销售长单、控参股关系、持续产品开发磨合等），公司面临不利竞争态势。此外，公司还需要不断扩充产品品类，并持续经历客户验证、市场开拓的过程。在上述竞争过程中，如果公司不能持续维持技术优势、有效保持和开拓境内外战略客户、降低成本、扩充产品品类，可能导致公司竞争力下降，而无法在國內市场维持优势，或在国际市场提升收入规模，从而难以实现公司经营目标。

## **2、经营业绩波动的风险**

### **(1) 经营业绩受半导体行业波动影响的风险**

公司所在半导体行业受宏观经济形势、下游终端需求等因素影响而具有一定的周期波动。根据 WSTS 统计，2024 年全球半导体市场销售额为 6,305.49 亿美元；2025 年，随着新兴市场需求增加、全球经济形势企稳、通胀有所放缓，以及各国持续出台半导体产业支持政策，全球半导体市场回暖，预计全年销售总额为 7,008.74 亿美元，同比增长 11.15%。报告期内，公司主营业务收入和主营业务毛利受半导体行业波动影响而呈现出一定波动。半导体行业的周期性波动受多种因素综合影响，具有一定不确定性，若由于宏观经济低迷、下游行业需求持续放缓、半导体行业政策出现不利变化、市场竞争加剧等因素而出现主要产品价格或销量下降等不利情况，公司收入、利润存在受半导体行业整体波动而降低的风险。

### **(2) 经营业绩受副产品市场价格波动影响的风险**

公司业绩受到副产品太阳能级多晶硅价格波动的影响，公司在生产电子级多

晶硅过程中，由于生产工艺特征，不可避免会产生部分副产品，等级未达到电子级，但可以应用于新能源领域，因此作为太阳能级多晶硅销售。公司副产品收入核算为其他业务收入，公司不会主动拓展副产品销售市场，主要由客户主动询购，公司参考市场公开价格进行销售。太阳能级多晶硅市场价格波动较大，在 2022 年至 2023 年经历了较为罕见的价格大幅波动。2022 年太阳能级多晶硅市场价格处于历史高位，且远高于历史均值，导致公司当年净利润基数较高；2023 年太阳能级多晶硅市场价格快速下跌，较 2022 年最大跌幅近 80%。因而，公司副产品相关收入及利润波动较大，进而可能导致整体业绩波动。

公司通过技术提升已将副产品产出率降至较低水平，且副产品太阳能级多晶硅市场价格已处于历史低位。但如果未来副产品太阳能级多晶硅市场价格再次出现大幅波动，仍可能在一定程度上影响公司整体业绩的波动，提醒投资者关注相关风险。

### **(3) 内蒙古鑫华投产新增折旧摊销影响经营业绩的风险**

内蒙 10,000 吨/年电子级多晶硅产线总体投资规模较高，内蒙产线投产后，2025 年 1 月至 9 月，月平均折旧额为 1,588.10 万元，对归母净利润影响额为每月 952.86 万元，对公司未来的经营业绩存在一定影响。若未来产业政策或市场环境等因素发生重大不利变化，则新增折旧摊销可能对本次募集资金投资项目效益造成不利影响，继而对公司未来的经营业绩产生不利影响。

### **3、毛利率波动的风险**

报告期内，公司综合毛利率分别为 23.81%、15.63%、22.44%和 24.56%，主营业务毛利率分别为 20.55%、16.84%、23.10%和 25.08%，存在一定波动。

2023 年度，公司综合毛利率水平有所下滑，主要系受到半导体行业波动以及副产品太阳能级多晶硅市场价格大幅下降的综合影响。公司电子级多晶硅产品中，质量要求更高的 P 级产品价格相对稳定，而 S 级产品价格受行业影响有所下降。此外，公司 2023 年 7 月产线进行升级改造，期间产线相关折旧、人工等停工损失提高了本期产品单位成本。前述因素导致 2023 年主营业务毛利率较上期有所下降。公司电子级多晶硅副产品的价格主要跟随太阳能级多晶硅市场价格而波动，2023 年太阳能级多晶硅市场价格大幅下跌导致其他业务毛利率从 36.91%

下降至 2.80%。

未来若公司不能保持较好的技术研发、成本控制和客户开发能力，产品竞争力有所下降，半导体市场持续低迷或继续下行，S 级电子级多晶硅产品价格继续下降，将影响公司主营业务毛利率；若副产品太阳能级多晶硅市场价格持续下降或保持低位，公司将面临其他业务毛利率继续下滑或持续较低的风险。前述因素均会导致公司综合毛利率波动，进而可能给公司生产经营活动带来不利影响。

#### **4、无实际控制人风险**

公司无控股股东和实际控制人。截至本上市保荐书出具之日，公司第一大股东合肥国材叁号及其一致行动人中建材新材料基金持股比例合计为 25.55%，第二大股东集成电路基金持股比例为 20.62%，均未超过 30.00%，并且合肥国材叁号和集成电路基金之间不存在一致行动关系。公司的单一股东依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东会的决议产生决定性影响，单一股东在董事会中提名的董事不足以对董事会的决议产生决定性影响，无法单独控制公司的董事会，也无法单方面决定公司及其下属公司的经营决策。充分制衡的股权结构有利于提高决策的科学性，但也可能影响公司的决策效率，在公司需要迅速做出重大经营、投资决策时，可能导致贻误发展机遇。此外，公司股权相对分散，使得公司未来有可能成为被收购对象，不排除上市后现有或新增股东通过增持公司股票导致公司股权结构发生变化，并可能导致董事会成员构成发生变化，甚至导致公司控制权发生变化。该等公司治理结构的变化可能会对公司经营管理和业绩的稳定性等带来不利影响。

#### **5、关联采购金额较大的风险**

报告期内，发行人向中能硅业购买商品及接受劳务金额分别为 45,837.97 万元、20,891.72 万元、16,019.91 万元和 14,000.03 万元，占报告期各期营业成本比重分别为 47.21%、26.17%、18.62%和 13.89%。发行人目前拥有 8,000 吨/年徐州产线和 10,000 吨/年内蒙产线两大生产基地，报告期内发行人与中能硅业之间的采购主要是发行人的徐州产线向其委托加工三氯氢硅、采购电力等。

报告期期初，发行人徐州产线生产所需三氯氢硅主要委托中能硅业加工，2022 年及 2023 年向中能硅业采购三氯氢硅金额分别为 28,564.90 万元、3,384.69

万元，占各期营业成本的比例分别为 29.42%、4.24%。发行人徐州产线自建三氯氢硅生产线于 2022 年底建设完成并开始投入使用，2023 年三氯氢硅关联采购金额及占比大幅下降。随着发行人徐州产线的三氯氢硅生产线逐渐达到稳定满产状态，2023 年 5 月后已不再委托中能硅业加工三氯氢硅。2025 年 9 月，因公司冷氢化产线停产检修，公司临时向中能硅业采购少量三氯氢硅，采购金额 600.66 万元。

发行人徐州产线建设时，由中能硅业和集成电路基金共同出资，中能硅业以实物产线注资，出资产线配套的原始电力设计方案和电力配套设施已固定。因此，发行人徐州产线的部分电力通过中能硅业采购，报告期内采购金额分别为 15,793.53 万元、14,264.94 万元、12,633.81 万元和 11,263.75 万元，占报告期内发行人营业成本比重分别为 16.27%、17.87%、14.68%和 11.18%。发行人徐州产线向中能硅业采购电力价格参照中能硅业向国家电网采购的电度用电价格（加成一定金额容/需量费）确定，定价公允。如果未来由于不可抗力等因素，导致前述中能硅业电力供应出现不稳定波动甚至中断情形，发行人需进行供电系统切换并重新配置电力设备等，可能导致徐州产线在一定期间内生产稳定性受到影响，并导致未来用电成本有所上升。发行人与中能硅业目前签署的能源供应合同有效期至 2036 年底。

## 二、本次发行情况

1、证券种类：人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：人民币 1.00 元。

3、发行数量：本次拟公开发行股票数量不低于 16,507.9366 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于发行后股本总额的 10%；本次公开发行的股份均为新股，不涉及股东公开发售股份；公司与主承销商可行使超额配售选择权，超额配售选择权不得超过首次公开发行股票数量的 15%。

4、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、上交所认可的其他方式。

5、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、

法规、规范性文件禁止购买者除外)。

6、拟上市地点：上海证券交易所科创板。

### 三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构	保荐代表人	项目协办人	其他项目组成员
招商证券股份有限公司	姜博、吴宏兴	赵国伟	汪军鹏、周长征、樊非凡、董丰田、罗文豪、刘李威、周天瑶、张墨涵、吕琛、付雨锋、袁振清

保荐代表人、项目组成员主要信息如下：

项目组	姓名	联系地址	电话	邮箱
保荐代表人	姜博	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	jiangbo2@cmschina.com.cn
保荐代表人	吴宏兴	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	wuhx@cmschina.com.cn
项目协办人	赵国伟	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	zhaoguwei@cmschina.com.cn
其他项目组成员	汪军鹏	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	wangjunpeng1@cmschina.com.cn
其他项目组成员	周长征	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	zhoucz@cmschina.com.cn
其他项目组成员	樊非凡	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	fanfeifan@cmschina.com.cn
其他项目组成员	董丰田	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	dongfengtian@cmschina.com.cn
其他项目组成员	罗文豪	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	luowenhao@cmschina.com.cn
其他项目组成员	刘李威	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	liuliwei2@cmschina.com.cn
其他项目组成员	周天瑶	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	zhoutianyao@cmschina.com.cn
其他项目组成员	张墨涵	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	zhangmohan@cmschina.com.cn
其他项目组成员	吕琛	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	lvchen@cmschina.com.cn
其他项目组成员	付雨锋	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	fuyufeng@cmschina.com.cn
其他项目组成员	袁振清	深圳市福田区福田街道福华一路111号	0755-82943666	yuanzhenqing@cmschina.com.cn

**(一) 保荐代表人近年主要保荐业务执业情况****1、招商证券姜博近年主要保荐业务执业情况如下：**

项目名称	保荐工作	是否处于持续督导期间
概伦电子科创板 IPO	担任保荐代表人	是
科达制造主板非公开发行	担任项目协办人	否
芯原股份科创板 IPO	担任项目协办人、持续督导保荐代表人	否

**2、招商证券吴宏兴近年主要保荐业务执业情况如下：**

项目名称	保荐工作	是否处于持续督导期间
概伦电子科创板 IPO	担任保荐代表人	是
百普赛斯创业板 IPO	担任保荐代表人	是
芯原股份科创板 IPO	担任保荐代表人	否
西麦食品主板 IPO	担任保荐代表人	是

**(二) 项目协办人赵国伟近年主要保荐业务执业情况**

项目名称	保荐工作	是否处于持续督导期间
国博电子科创板 IPO	担任项目组成员	是

**(三) 本次证券发行项目协办人及其他项目组成员**

其他项目组成员：汪军鹏、周长征、樊非凡、董丰田、罗文豪、刘李威、周天瑶、张墨涵、吕琛、付雨锋、袁振清。

**四、保荐机构与发行人之间的关联关系**

**(一) 保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况**

发行人无控股股东、无实际控制人。

经向上逐层穿透，保荐机构招商证券通过衍生品投资业务、子公司等主体间接持有发行人少量股份，累计间接持股比例低于千分之一。该等情况均为相关投资主体的市场化行为，不属于法律法规禁止持股的情形或利益冲突情形。

除上述相关情况外，截至本上市保荐书出具之日，保荐机构或其控股股东、

实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其重要关联方股份而影响保荐机构独立性的情形，也不存在影响保荐机构和保荐代表人公正履行保荐职责的情况。

保荐机构将安排子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

## **（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况**

发行人无控股股东、无实际控制人。除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，发行人或其重要关联方不存在持有本保荐机构或本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情形。

## **（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况**

本保荐机构的保荐代表人及其配偶不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况。除上述已说明的情形外，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情形。

## **（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况**

发行人无控股股东、无实际控制人。本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情形。

## **（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系**

除上述说明外，保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系。

## **五、保荐机构的承诺**

本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，做出如下承诺：

（一）本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同意推荐发行人

证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

(二) 保荐机构有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定。

(三) 保荐机构有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四) 保荐机构有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。

(五) 保荐机构有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。

(六) 所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。

(七) 保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(八) 对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范。

(九) 自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

(十) 自愿遵守中国证监会规定的其它事项及上海证券交易所的自律监管。

## **六、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序**

### **(一) 发行人董事会对本次证券发行上市的批准**

2025年11月23日，发行人依法召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于〈首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案〉的议案》《关于提请股东会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市相关事宜的议案》和其他相关议案，同意发行人本次发行上市的相关事项，并将上述议案提请发行人于2025年11月24日召开的

2025 年第六次临时股东会审议。

## **(二) 发行人股东会对本次证券发行上市的批准、授权**

2025 年 11 月 24 日，发行人依法召开了 2025 年第六次临时股东会，审议通过《关于〈首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案〉的议案》《关于提请股东会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市相关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。

## **七、保荐机构对发行人符合科创板定位的核查情况**

### **(一) 核查内容与核查过程**

针对科创板定位要求，保荐机构进行了如下核查工作：

- 1、核查历次工商变更资料，取得发行人及其子公司工商登记资料；
- 2、访谈了发行人高级管理人员、核心技术人员及相关业务负责人，对公司的经营模式、行业情况、科技创新等情况进行了解；
- 3、查阅了发行人组织架构图、公司内控制度及执行文件，了解公司各部门职能及运营情况、内控制度执行情况；
- 4、访谈了发行人核心技术人员及研发部门员工，取得了发行人研发项目清单，了解发行人核心技术形成过程、研发战略、研发部门体系设置、研发机制、研发储备项目情况；
- 5、查阅了发行人专利产权证书等，确认发行人知识产权权属清晰；
- 6、核查发行人及其产品所获得的荣誉奖项资料，取得发行人荣誉证书；
- 7、查阅了发行人的主要客户和供应商的公开信息，实地走访发行人主要客户和供应商，取得了发行人主要客户和供应商的工商资料、走访记录及无关联关系承诺函；
- 8、核查了发行人的人员名册、劳动合同等资料，取得了发行人研发人员及其背景情况；
- 9、核查了发行人会计师出具的审计报告，取得了发行人报告期内的财务数据，确认发行人报告期内收入及净利润增长的成长性及研发投入情况；

10、查询中国“裁判文书网”、“全国法院被执行人信息查询系统”、“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”等公示系统，查询公司及其子公司、董事及高级管理人员诉讼和纠纷情况；

11、查阅了发行人所在行业政策文件、专业研究报告及数据，了解发行人行业地位、市场竞争格局、下游市场空间等行业情况；

12、查阅了发行人同行业公司的公开披露资料，了解发行人同行业公司的业务、产品及技术水平情况。

经核查，本保荐机构认为发行人具有科创属性，符合科创板定位，推荐其在科创板发行上市。

## （二）核查意见

### 1、发行人符合科创板行业领域要求

发行人主营业务为半导体产业用电子级多晶硅的研发、生产与销售。

根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，发行人所属行业属于“鼓励类”，第九条第 4 款“新材料”中“半导体、芯片用电子级多晶硅（包括区熔用多晶硅材料）”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，发行人所属行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“C3985 电子专用材料制造”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人所属行业属于“3 新材料产业”之“3.4 先进无机非金属材料”之“3.4.3 人工晶体制造”之“3.4.3.1 半导体晶体制造”。

根据《申报及推荐暂行规定》，发行人行业领域归属于第四条第（三）项“新材料领域”，符合科创板行业领域要求。

### 2、发行人科创属性符合要求

根据《科创属性评价指引（试行）》，发行人符合科创属性评价标准一，具体情况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5% 以上，或最近三年研发投入金额累计在 8000 万元以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2022 年至 2024 年，公司累计研发投入 18,184.84 万元，占最近三年累计营业收入比例为 5.46%，超过 8,000 万元，并超过 5%

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2024 年 12 月 31 日，公司研发人员 114 人，占期末员工总数比例为 12.74%，超过 10%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至本上市保荐书出具之日，应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 53 项，超过 7 项
最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2024 年度营业收入 110,964.15 万元，大于 3 亿元

综上所述，发行人符合科创板定位要求，符合《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等法规的规定。

### 3、发行人科技创新能力突出

发行人的核心技术是发行人的主要竞争力之一。经过多年的技术实践与积累，发行人突破并优化了多项关键技术，自主研发了电子级多晶硅长周期稳定量产产业化技术、ppt 级氯硅烷痕量杂质纯化技术、高效 CVD 可控晶体沉积技术、硅棒洁净破碎、硅块洁净刻蚀等 11 项主要核心技术，构建了较高的技术壁垒，发行人拥有的改良西门子法电子级多晶硅生产工艺技术已处于国际先进水平。

依托在电子级多晶硅领域的技术积累，发行人积极承担国家及地方重大科技攻关任务。发行人是国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》（02 专项）中《电子级多晶硅材料研发》的具体实施单位；发行人承接了工信部“国家工业强基工程”项目，已顺利完成验收；同时，发行人还承担了“江苏省工业和信息产业转型升级项目”“江苏省关键核心技术攻关项目”以及“江苏省重点研发计划项目”等多项省级重点科技专项。此外，发行人积极参与国家及行业标准体系建设，作为牵头单位完成了最新版《电子级多晶硅》（GB/T 12963-2022）国家标准的修订，并参与多项国家标准、行业标准的制定和修订工作。发行人是国家级专精特新“小巨人”企业。

### 4、发行人主营业务符合国家产业政策的要求

发行人主要从事半导体产业用电子级多晶硅的研发、生产与销售。半导体制造产业链始于电子级多晶硅，至半导体硅片和晶圆制造，最终产出集成电路芯片用于终端产品。作为我国实现高水平科技自立自强的重要产业领域，半导体制造产业具有重大战略意义。发行人生产的电子级多晶硅是支撑整个半导体制造产业的关键基础材料，直接应用于半导体硅片与半导体用硅部件生产。

发行人所处的电子专用材料制造行业属于国家战略性、基础性产业，对支撑经济社会发展和保障产业链供应链安全具有重要作用，是我国重点鼓励发展的方向。近年来，国家陆续出台一系列政策措施，积极引导和支持该行业高质量、可持续发展。行业主要适用的法规及政策包括：

发布时间	发布单位	政策/文件名称	产业相关内容
2024年	工业和信息化部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用
2023年	工业和信息化部	《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》	区熔用多晶硅材料属于先进半导体材料，被列入指导目录
2023年	工信部	《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》	面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G通信、智能网联汽车等重点领域，推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关；面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力
2023年	工业和信息化部等六部门	《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	面向光伏、风电、储能系统、半导体照明等，发展新能源用耐高温、耐高压、低损耗、高可靠IGBT器件及模块，SiC、GaN等先进宽禁带半导体材料与先进拓扑结构和封装技术，新型电力电子器件及关键技术
2022年	国务院	《关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》	提升核心产业竞争力。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力
2021年	工业和信息化部	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	实施重点产品高端提升行动，面向电路类元器件等重点产品，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足电子元器件发展短板，保障产业链供应链安全稳定
2021年	十三届全国人大四次会议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	在事关国家安全和全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。其中集成电路行业包括：集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管（IGBT）等
2020年	国家发改委、科技部、工信部、财政部	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	加快新材料产业强弱项。围绕保障微电子制造等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破
2020年	国务院	《新时期促进集成电路产业	国家鼓励集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第

发布时间	发布单位	政策/文件名称	产业相关内容
		和软件产业高质量发展若干政策》	二年免征收企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率或减半
2019年	工信部	《关于政协十三届全国委员会第二次会议第2282号提案答复函》	持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展，根据产业发展形势，调整完整政策实施细则，更好地支持产业发展
2018年	工信部	重点新材料首批次应用示范指导目录（2018年版）	在先进半导体材料和新型显示材料下列示了大尺寸硅电极产品、大尺寸硅环产品，适用于重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作
2018年	财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工信部	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》	对满足要求的集成电路生产企业实行税收优惠减免政策，符合条件的集成电路生产企业可享受前五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止的优惠政策

发行人的主要产品和业务受到国家政策的鼓励与支持，符合产业政策和国家经济发展战略。

综上所述，发行人所属行业领域和科创属性皆符合科创板定位要求，符合《科创属性评价指引（试行）》《申报及推荐暂行规定》等法规的规定。

## 八、保荐机构关于发行人符合科创板上市条件的说明

### （一）发行人符合《注册管理办法》有关规定

#### 1、符合《注册管理办法》第十条相关发行条件

##### （1）发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司

根据《发起人协议》、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（毕马威华振审字第2600076号）、发行人历次股东会、董事会会议决议、发行人现行有效的《公司章程》、发行人律师北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》《企业法人营业执照》等文件和本保荐机构的核查，发行人系由鑫华有限的全体股东作为发起人，以鑫华有限截至2022年1月31日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，于2022年3月30日取得徐州市行政审批局核发的统一社会信用代码为

91320301MA1MCPLL8F 的《营业执照》，自鑫华有限设立之日起算，发行人持续经营时间已超过 3 年。

## **(2) 发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责**

根据发行人《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》、内部控制制度、历次“三会”会议通知、会议决议、会议纪要等文件及本保荐机构的核查，发行人已依法建立了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书等公司治理体系。发行人目前有 11 名董事，其中 4 名为发行人选任的独立董事；董事会下设 4 个专门委员会即：审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

根据本保荐机构的核查以及发行人的说明、发行人审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏鑫华半导体科技股份有限公司内部控制审计报告》、发行人律师北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》，发行人设立以来，股东会、董事会能够依法召开，规范运作；股东会、董事会决议能够得到有效执行；重大决策制度的制定和变更符合法定程序。

经本保荐机构及其他中介机构的辅导，并经发行人书面确认，发行人的董事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事和高级管理人员的法定义务和责任，相关机构和人员能够依法履行职责。

经核查发行人的内部控制制度及其执行情况、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（毕马威华振审字第 2600075 号），本保荐机构认为发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

综上所述，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

## 2、符合《注册管理办法》第十一条相关发行条件

根据查阅和分析毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（毕马威华振审字第 2600076 号）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《江苏鑫华半导体科技股份有限公司内部控制审计报告》（毕马威华振审字第 2600075 号）、发行人的重要会计科目明细帐、重大合同、财务制度、经主管税务机关确认的纳税资料、关联交易的会议记录、同行业公司经营情况、内部控制制度及其执行情况、发行人的书面说明或承诺等文件和本保荐机构的核查，本保荐机构认为：

1、发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。

2、发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告。

综上所述，发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且被有效执行，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

## 3、符合《注册管理办法》第十二条相关发行条件

（1）经核查发行人业务经营情况、主要资产、专利、商标等资料，实地核查有关情况，并结合主要股东调查表及对发行人董事和高级管理人员的访谈等资料。保荐机构认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与主要股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（2）经核查发行人报告期内的主营业务收入构成、重大销售合同及主要客户等资料，发行人最近 2 年内主营业务未发生重大不利变化；经过对发行人历次股东会、董事会决议资料、工商登记资料等文件的核查，本保荐机构认为发行人最近 2 年内董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大变化，主要股东和受主要股东支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有

发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

(3) 经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件等资料，结合与发行人管理层的访谈、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（毕马威华振审字第 2600076 号）和发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

综上，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力。发行人符合《注册管理办法》第十二条的规定。

#### **4、符合《注册管理办法》第十三条相关发行条件**

保荐机构查阅了发行人的《营业执照》、主要业务合同、所在行业管理体制和行业政策，取得相关机构出具的工商、税务、社保、环保等方面合规证明文件，进行公开信息查询，并获取发行人主要股东、董事、高级管理人员提供的书面文件，查阅了董事、高级管理人员的无犯罪记录证明。

经核查，保荐机构认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；发行人无控股股东、实际控制人，最近 3 年内，发行人及下属子公司不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；发行人董事、高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

综上，发行人符合《注册管理办法》第十三条的规定。

### **（二）发行人符合《上市规则》规定的发行条件**

#### **1、发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元且公开发行的股份达到公司股份总数的 10%以上**

发行人目前的股本总额为人民币 148,571.4288 万元。根据发行人股东会决议，

发行人拟向社会公开发行不低于 16,507.9366 万股社会公众股，按发行 16,507.9366 万股测算，本次发行后发行人的股本总额将变更为 165,079.3654 万股，其中公开发行的股份将占发行人本次发行后股份总数不低于 10%。发行人发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元，且公开发行的股份达到公司股份总数的 10%以上，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条的第（二）项、第（三）项条件。

## 2、市值及财务指标符合《上市规则》有关规定

发行人本次上市选择的上市标准为《上市规则》第 2.1.2 条第四款，即“预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

### （1）发行市值情况

根据发行人 2023 年 3 月外部融资投后估值、2025 年 9 月股权转让对应估值以及同行业 A 股上市公司估值情况，基于对发行人预计市值的预先评估，预计发行后总市值不低于 30 亿元。故发行人满足《上市规则》第 2.1.2 条第四款之预计市值标准。

### （2）发行人财务指标情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（毕马威华振审字第 2600076 号），发行人最近一年营业收入为 110,964.15 万元，超过人民币 3 亿元。故发行人满足《上市规则》第 2.1.2 条第四款之营业收入标准。

综上，本保荐机构认为，发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《上市规则》规定的上市条件。

## 九、对公司持续督导期间的工作安排

事项	安排
（一）持续督导事项	
1. 督导发行人及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的各项承诺。	根据相关法律法规，督促发行人及其董事、高级管理人员学习和遵守相关规范，切实履行承诺。
2. 督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事和高级管理人员的	根据相关法律法规，协助发行人制订、完善有关制度，并督导其执行。

事项	安排
行为规范等。	
3. 督导公司有效执行并完善防止关联方违规占用公司资源的制度。	根据相关法律法规，协助公司制订、完善有关制度，并督导其执行。
4. 督导公司有效执行并完善防止高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度。	根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，协助公司制定有关制度并督导其实施。
5. 督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见。	督导公司的关联交易按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易，本机构将按照公平、独立的原则发表意见。 公司因关联交易事项召开董事会、股东会，应事先通知本保荐机构，本保荐机构可派保荐代表人与会并提出意见和建议。
6. 督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件。	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定。
7. 持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。	督导发行人按照《募集资金管理制度》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见。
8. 持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。	督导发行人遵守《公司章程》《对外担保管理办法》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定。
9. 持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况。	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息。
10. 关注发行人或其第一大股东、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上交所监管措施或者纪律处分的情况。	督导发行人及其第一大股东、董事、高级管理人员遵守相关法律法规，与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息，持续关注相关主体是否存在受到中国证监会行政处罚、交易所监管措施或者纪律处分的情况。
11. 持续关注发行人及第一大股东等履行承诺的情况。	督导发行人及其第一大股东切实履行承诺，持续关注相关主体承诺履行情况。
12. 根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查。	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查。
13. 中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。	保荐机构、保荐代表人会针对发行人的具体情况，切实履行各项持续督导职责。
(二) 持续督导期间	发行人首次公开发行股票并在科创板上市当年剩余时间以及其后3个完整会计年度；持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，本保荐机构将继续完成。
(三) 发行人应当积极配合保荐机构履行持续督导职责	发行人承诺积极配合本保荐机构履行持续督导职责，包括：及时提供履行持续督导职责必需的相关信息；发生应当披露的重大事项、出现重大风险的，及时告知保荐机构和保荐代表人；及时履行信息披露义务或者采取相应整改措施；协助保荐机构和保荐代表人披露持续督导意见；为保荐机构和保荐代表人履行持续督导职责提供其他必要的条件和便利。

## 十、保荐机构认为应当说明的其他事项

无。

## 十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

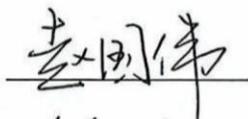
本保荐机构认为：江苏鑫华半导体科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《上市规则》等法律、法规的相关要求，其股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。招商证券同意担任江苏鑫华半导体科技股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在上海证券交易所科创板上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页)

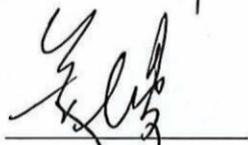
项目协办人

签名: 赵国伟

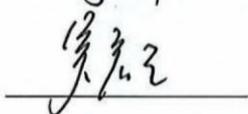


保荐代表人

签名: 姜 博



签名: 吴宏兴



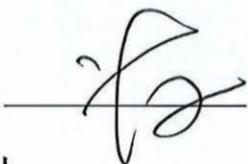
内核负责人

签名: 吴 晨



保荐业务负责人

签名: 刘 波



保荐机构法定代表人

签名: 霍 达



2026年 2月 9 日